



接触垫片

TE Connectivity (TE) 最新推出的接触垫扩展产品，为表面贴装 (SMT) 应用提供坚固的全金属镀金解决方案。其工程设计具备显著的耐用性与稳定性，有助于消除标准铜箔的局限性，提供更优异的连接接触。在严苛的项目中实现更高的设计灵活性与长期可靠性。

目标应用

消费类电子产品

- 可穿戴设备（如智能手表、无线耳机）
- 平板电脑
- 智能扬声器

医疗便携式设备

- 动态血糖监测 (CGM)
- 助听器

工业领域

- 工业平板电脑
- 测试设备

主要优势和特点

设计灵活性

- 提供多种直径和高度规格，匹配您的元件布局与机械外壳要求
 - 直径: 1.5mm, 1.98mm, 2.99mm
 - 厚度: 0.64mm, 0.8mm, 1.14mm, 1.4mm, 1.91mm

高可靠性

- 全金属主体镀金层，有效提升导电性与抗氧化性能
- 相较于普通铜箔，可提供更稳定的连接并降低现场故障率

兼容性

- 适用于弹簧针、弹簧指和测试探针的理想导电配合面

高效组装

- 扁平圆形设计适配 SMT (表面贴装技术) 焊接工艺，助力自动化生产并简化制造流程

标准产品系列

型号	镀层	直径	厚度
2511417-1	金	1.98mm	0.64mm
2511417-2	金	1.98mm	1.4mm
2511417-3	金	1.98mm	1.4mm
2511418-1	金	2.99mm	1.4mm
2511418-2	金	2.99mm	1.91mm
2511420-1	金	1.5mm	0.8mm

[LEARN MORE ▶](#)

TE Connectivity

数字数据网络

te.com

TE、TE Connectivity、TE Connectivity（标识）和 EVERY CONNECTION COUNTS 是由 TE Connectivity 集团公司拥有或授权的商标。此处提到的其它产品、标志和/或公司名称为其各自所有者的商标。

本白皮书中的信息，包括仅为说明产品目的而使用的图纸、插图和图表，据信为可靠信息。但是，TE Connectivity 不对这些信息的准确性或完整性做出任何保证，且不对这些信息的使用承担任何责任。TE Connectivity 的义务仅在 TE Connectivity 的该产品标准销售条款和条件中规定，并且在任何情况下，TE Connectivity 均不对产品销售、转售、使用或误用造成的偶然的、间接性的或结果性的损失承担赔偿责任。TE Connectivity 产品的使用者应自行评估并确定每种产品是否适用于特定用途。

© 2026 TE Connectivity.版权所有。

01-26